

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Vom Klang einer Orgel und von der Technik des Lötens	1
--	---

J. Schmidt, Berlin

Flussmittel- und Feststoffanteile in modernen Lötmitteln – Visionen und (Mindest-) Anforderungen	4
--	---

U. Grimmer-Herklotz, Oberhausen

Optimierung der SMT-Prozesse für die Reel-to-Reel-Fertigung	11
---	----

J. Niemeier, Berlin

Wie genau müssen SMT-Bauteile bestückt werden?	17
--	----

Norbert Heilmann, München

Induktionserwärmung für das Cu-Sn SLID-Waferbonden zum Packaging in der Mikrosystemtechnik	23
--	----

C. Hofmann, M. Wiemer, A. Fröhlich und M. Kroll, Chemnitz

Reaktive Multilagensysteme als interne Wärmequelle zum Fügen auf Wafer-, Chip- und Komponentenebene.....	29
--	----

K. Vogel, S. Hertel, F. Roscher, M. Wiemer und S. Zimmermann, Chemnitz

Materialien und Materialkombinationen zur präzisen Positioniergenauigkeit	35
---	----

J. Trodler, S. Gunst, J. Ehmes und Stefan Merlau, Hanau; H. Wohlrabe und O. Albrecht, Dresden

Autorenverzeichnis	46
---------------------------------	-----------